

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Podstawowy element modułowej obudowy CH20M oferuje szereg zalet, które sprawiają, że jest to doskonały wybór dla Państwa projektów. Dzięki specjalnym wycięciom na magistrale i styki FE jest szczególnie elastyczny i łatwy w adaptacji.

Kolejnym punktem zapewniającym wartość dodaną jest opcja druku laserowego na obudowie, która zapewnia wysoką precyzję i możliwości w zakresie indywidualnego designu. Dostępna jest również szeroka gama kolorystyczna, dzięki czemu można zaprojektować obudowę całkowicie zgodnie z życzeniem klienta.

Obudowa CH20M jest również dopasowana do standardowych szyn montażowych, co ułatwia instalację i integrację z istniejącymi systemami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Obudowa szyny montażowej, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element boczny, przygotowanie połączenia, karta micro-SIM (3FF), Szerokość: 45 mm
Nr zam.	2738670000
Typ	CH20M45 B SIM BK/BK 2010
GTIN (EAN)	4064675064091
Ilość	6 szt.

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane ogólne

Barwny	czarny	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Szyna montażowa	TS 35	Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011
możliwość zalewania	Nie		

Testy termiczne

Testy termiczne	Ogólne wskazówki dotyczące testowania	Wszystkie testy techniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
	Warunki testu	siedem obudów zamontowanych w rzędzie - brak odstępu
	Badane osie	poziomy
	Temperatura otoczenia	55 °C
	Rozpraszanie mocy, maks.	4.2 W
	Temperatura otoczenia	50 °C
	Rozpraszanie mocy, maks.	4.8 W
	Temperatura otoczenia	40 °C
	Rozpraszanie mocy, maks.	5.9 W
	Temperatura otoczenia	20 °C
Rozpraszanie mocy, maks.	8.25 W	

Właściwości komponentu

Kolor stopki przyczepianej	czarny	Wycięcie w obszarze stopki zatraskowej Karta Micro SIM (3FF) jako przygotowanie do
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks 3		

Projekt – wymagania IN

tolerancja konturu płytki drukowanej	±0,1 mm	grubość płytki drukowanej	1.6 mm
tolerancja grubości płytki drukowanej	±0,15 mm		

Opcje indywidualizacji

Możliwość zastosowania etykiet specjalnych	Tak	Proces zamówienia na życzenie klienta	Patrz wytyczne w sekcji do pobrania
Warianty kolorystyczne	Więcej na życzenie	Możliwości obróbki	Obróbka laserowa

Ważna informacja

Informacje produktowe	Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.
-----------------------	--

Klasyfikacje

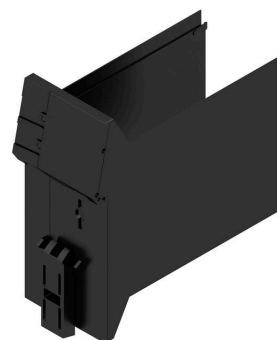
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Rysunki

Zdjęcie produktu



Zalety produktu



Basiselement einschließlich SIM-Ausschnitt

Rysunek wymiarowy

